

平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月27日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 ニューフレアテクノロジー

コード番号 6256 URL <http://www.nuflare.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 重光文明

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務部長 (氏名) 天明郁夫

TEL 045-471-1982

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	15,533	62.4	6,149	993.3	6,042	—	3,444	—
23年3月期第2四半期	9,563	44.6	562	—	391	—	215	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 3,465百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 194百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	28,706.19	—
23年3月期第2四半期	1,792.32	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	37,998	12,773	33.6
23年3月期	40,359	9,428	23.4

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 12,773百万円 23年3月期 9,428百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0.00	—	1,000.00	1,000.00
24年3月期	—	0.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5,000.00	5,000.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	35,000	13.9	12,300	288.9	12,100	328.5	6,800	331.5	56,666.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
- ② ①以外の会計方針の変更 ： 無
- ③ 会計上の見積りの変更 ： 無
- ④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

24年3月期2Q	120,000 株	23年3月期	120,000 株
24年3月期2Q	― 株	23年3月期	― 株
24年3月期2Q	120,000 株	23年3月期2Q	120,000 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想通知は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（その他）に関する事項	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
(3) 継続企業の前提に関する注記	6
(4) セグメント情報等	6
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サプライチェーンの立て直しや各種の政策効果等から着実な持ち直し傾向がみられるものの、急激な円高や不安定な海外経済の影響により、景気の回復は緩やかに推移しました。

当社グループが事業を行なう半導体業界においては、スマートフォンやタブレットPC向け半導体の市場には減速感がみられたものの、当社グループの顧客においては、先端半導体製造関連装置向け設備投資に積極的な姿勢がみられました。

このような状況のもとで、当社グループは、主力の電子ビームマスク描画装置及びエピタキシャル成長装置の拡販に努めてまいりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は15,533,372千円（前年同期比62.4%増）、営業利益6,149,133千円（前年同期比993.3%増）、経常利益6,042,719千円（前年同期比1,443.0%増）、四半期純利益3,444,743千円（前年同期比1,501.6%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における資産は、37,998,866千円（前連結会計年度末比2,360,396千円減）となりました。これは、現金及び預金、仕掛品等が増加した一方で、受取手形及び売掛金、有形固定資産等が減少したことが主な要因となっております。

当第2四半期連結会計期間末における負債は、25,225,207千円（前連結会計年度末比5,705,632千円減）となりました。これは、未払法人税等、支払手形及び買掛金等が増加した一方で、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金等が減少したことが主な要因となっております。

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、12,773,658千円（前連結会計年度末比3,345,236千円増）となりました。これは利益剰余金の増加が主な要因となっております。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災の影響により、資材の調達等において厳しい経営環境となることを見込んでおりましたが、震災の影響は想定を下回る見込みとなりました。さらに、主力の電子ビームマスク描画装置のコスト削減及び経営全般における経費削減の効果も想定以上に寄与することが見込まれることから、平成24年3月期連結通期の業績予想及び配当予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成23年10月27日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年 3 月 31 日)	当第 2 四半期連結会計期間 (平成23年 9 月 30 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	15,969,529	16,412,353
受取手形及び売掛金	10,322,731	6,846,862
商品及び製品	164,465	79,493
仕掛品	5,096,526	6,775,734
繰延税金資産	1,116,413	1,239,760
その他	279,411	182,304
流動資産合計	32,949,078	31,536,509
固定資産		
有形固定資産	6,060,912	5,083,857
無形固定資産	729,613	789,043
投資その他の資産	619,657	589,456
固定資産合計	7,410,183	6,462,357
資産合計	40,359,262	37,998,866
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,849,008	8,415,485
短期借入金	6,000,000	—
1年内返済予定の長期借入金	1,900,000	200,000
未払法人税等	2,224,076	2,823,086
製品保証引当金	292,873	609,607
その他	5,997,399	6,554,884
流動負債合計	24,263,357	18,603,064
固定負債		
長期借入金	4,500,000	4,500,000
退職給付引当金	1,228,265	1,276,013
役員退職慰労引当金	15,379	—
資産除去債務	247,012	249,857
その他	676,825	596,271
固定負債合計	6,667,482	6,622,142
負債合計	30,930,839	25,225,207
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,486,000	6,486,000
資本剰余金	1,986,000	1,986,000
利益剰余金	971,371	4,296,114
株主資本合計	9,443,371	12,768,114
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△14,948	5,544
その他の包括利益累計額合計	△14,948	5,544
純資産合計	9,428,422	12,773,658
負債純資産合計	40,359,262	37,998,866

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	9,563,776	15,533,372
売上原価	5,549,185	5,267,802
売上総利益	4,014,591	10,265,569
販売費及び一般管理費	3,452,132	4,116,436
営業利益	562,458	6,149,133
営業外収益		
受取利息	2,355	5,305
受取賃貸料	8,846	7,147
その他	4,070	7,577
営業外収益合計	15,272	20,031
営業外費用		
支払利息	150,279	92,485
為替差損	12,003	10,185
その他	23,834	23,772
営業外費用合計	186,117	126,444
経常利益	391,613	6,042,719
特別損失		
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	101,834	—
特別損失合計	101,834	—
税金等調整前四半期純利益	289,778	6,042,719
法人税、住民税及び事業税	19,500	2,773,200
法人税等調整額	55,200	△175,224
法人税等合計	74,700	2,597,976
少数株主損益調整前四半期純利益	215,078	3,444,743
四半期純利益	215,078	3,444,743

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	215,078	3,444,743
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△20,762	20,493
その他の包括利益合計	△20,762	20,493
四半期包括利益	194,316	3,465,236
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	194,316	3,465,236
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

当社グループは半導体製造装置、同部品の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(開示の省略)

四半期連結キャッシュ・フロー計算書、その他の注記事項、個別情報、補足情報等は第2四半期決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略しております。